

センサ用 パッケージ基板

Packaging Substrate for Sensor

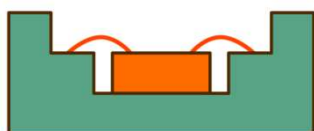


IoT、ウェアラブル機器、さらに自動車関連など、自動化の技術が進むにつれ多種多様のセンサが開発されています。私たちは、これまで培った材料や加工技術を活用し、お客様の先進的な製品作りへのご要望にお応えします。



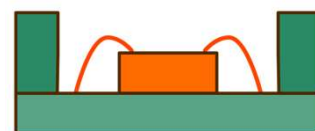
キャビティ

樹脂基板を段加工して、チップを入れ込む構造を形成します。一体構造ですので、信頼性の高い製品が可能です。



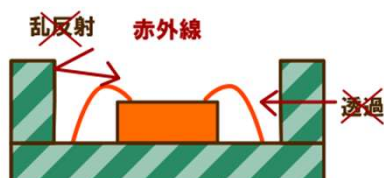
貼り合わせ

ベース基板に窓加工した枠板を貼り合わせてキャビティ構造を形成します。



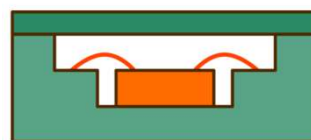
赤外線遮蔽

光の反射や透過を抑えることで、センサの誤作動や感度の低下を防ぎます。



MEMS構造

樹脂基板にチップを実装し、ふた(lid)を貼り付けて中空パッケージを形成します。



日本ミクロン株式会社

www.nihon-micron.co.jp

☎ 0266-23-8373

(土日・弊社指定休日を除く8:30~17:20)

✉ nmadpt@nihon-micron.co.jp

FAX 0266-23-1223

